

<<实用表面组装技术>>

图书基本信息

书名：<<实用表面组装技术>>

13位ISBN编号：9787505373730

10位ISBN编号：7505373730

出版时间：2002-2

出版时间：电子工业出版社

作者：张文典

页数：393

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<实用表面组装技术>>

内容概要

表面组装技术（SMT）发展已有近40年的历史，现已广泛应用于通信、计算机、家电行业，并正在向高密度、高性能、高可靠性和低成本方向发展。

本书较详细地介绍了SMT的相关知识。

全书共有十五章，包括焊接机理、SMT工艺设计的要求。

热传导基本概念、各种辅助材料的特性与评估方法、各种焊接设备的热传导特点以及焊接曲线的设定、贴片机验收标准、焊点质量评价与SMA性能测试技术、SMT大产生中的防静电及质量管

<<实用表面组装技术>>

书籍目录

- 1, 概论
 - 2, 表面安装元器件
 - 3, 表面安装用的印制电路板
 - 4, 焊接机理与可焊性测试
 - 5, 助焊剂
 - 6, 锡铅焊料合金
 - 7, 焊锡膏与印刷技术
 - 8, 贴片胶与涂布技术
 - 9, 贴片技术与贴片机
 - 10, 波峰焊接技术与设备
 - 11, 再流焊
 - 12, 焊接质量评估与检测
 - 13, 清洗与清洗剂
 - 14, 电子产品组装中的静电防护技术
 - 15, SMT生产中的质量管理
- 参考文献

<<实用表面组装技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>